GaAs晶片的光辐射加热

佟跃军 侯 洵

(中科院西安光机所)

【提要】本文描述了一种用高强度会聚光辐射对真空系统中的 Ga As 晶片进行加热清洁的方法。对光强及目标温度间的关系进行了计算及实验验证。根据升温曲线,可通过调节光源参数来控制目标温度。

一、引言

GaAs 晶片经化学清洗后其表面吸附有碳和氧之类的污染物,而这些污染物的清除对于表面科学、半导体材料及器件制备等方面的研究是至关重要的。为此,人们常常采取多种措施进行清洁处理,其中真空加热(1),电子表击加热(2),电子表击加热(3),辐射加热(4,5)等方法。当然,这些方法都各有其优缺点,可根据不同的目的和式GaAs(Cs,O)光电阴极及有关器件时,真空度要求要高,对于受处理的表面,要尽量少受损伤单。我们选用外面会聚光辐射加热的方法来加以实现。本实的目的就是介绍应用这一方法的一些结果。

二、加热装置

图 1 为加热装置示意图。光源为3000W 卤钨灯。光束经椭球反射镜后再 经 透 镜 会 聚,通过真空窗口而入射到需加热的样品上 (当真空窗口径较大时,不另加透镜以减少 光能损失)。 在实验中, 采用铂铑-铂热电 偶进行温度测量, x-y记录仪记录升、 降温曲线,入射光强用能量计测量。为了保证测量的可靠性,用红外双波段测温仪进行测温 (为避免光辐射的影响,采用水层滤波的办法:使入射光波长保持小于1.4μm,而把长波部分加以消除)。

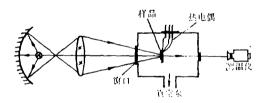


图 1 加热系统示意图

调整光源、透镜及目标间的距离可使光 斑面积的大小获得改变。光斑面积一般选为 2×1.5cm²,这时(在同样光源电压下)光 斑最亮。晶片尺寸约为1×1cm²。光斑中不 同点的温度差不超过5°C。GaAs在600°C左 右的热扩散率为10⁻¹cm²/s的数量级(可认 为热扩散是很快的)。在晶片上不同点的温差 小于5°C,因此,热均匀性是满足要求的。

此加热装置有这样一些优点。 Ga As 对 波长小于 1µm的辐射有强烈的吸收, 而卤钨 灯的光谱辐射在小于 1µm范围内占大部分,

本文修改稿于1987年8月12日收到。

这样一来, GaAs 吸收光谱与卤钨灯发射光 谱闻的匹配性好,从而可使加热效率提高, 卤钨灯成本低,能量转换效率高,可通过选 择滤波器改变照射辐射的平均吸收深度,使 加热集中在表面层,而不致使半导体内部掺 杂引起变化,加热装置在真空系统外部,而 受热部件在其内部,故其加热过程中不会污 染系统,而且操作也极方便,加热面 积较 大,均匀性亦好。

三、光强与温度的关系

在大部分入射辐射波长范围内, Ga As 晶片有强烈的吸收[6]。当晶片较厚(0.5mm)时,约3µm以上波段的辐射就被透镜或玻璃窗阻截,晶片上没有被反射掉的辐射,可以认为被全部吸收。当晶片吸收光能后温度立即升高,同时晶片也向外辐射能量(损失能量)。由于晶片是在真空系统中,样品架又是较细的镍丝,因此,吸收能量与损失能量很快达到平衡,而使温度达到极大值。

设入射光强为 $I(W/cm^2)$,晶片厚度为d(cm),反射率R,密度 $\rho(g/cm^3)$, 比热 $c[J/(g\cdot K)]$,发射系数 ϵ , 斯特藩-玻尔兹曼常数 σ 。经推导可得以下方程

$$\frac{1}{4} \ln \frac{1 + (b/a)^{1/4}T}{1 - (b/a)^{1/4}T} + \frac{1}{2} \operatorname{arctg}(b/4)^{1/4}T$$

$$= (b/a)^{1/4}at + c_1 \qquad (2)$$

和降温曲线方程

$$1/T^8 = 3bt + c_2 (3)$$

式中, $a = I(1-R)/(\rho cd)$, $b = 2\varepsilon\sigma/(\rho cd)$, c_1 , c_2 为由初始条件确定的积分常数。

晶片最大温度T_m与I的关系可由令(1) 式为零求得

$$I(1-R) = 2\varepsilon R T_m^4 \tag{4}$$

由(2)和(3)两式可画出升、降温曲线,如图2所示。图中曲线是 I = 5.3W/cm²作出的。由图可见。开始温度上升很快,到10s 后减缓,最后达到饱和。停止加热后温度下降很快。由(4)式可作出光强 I 与晶片最高温度 T m的关系曲线,如图 3 所示。

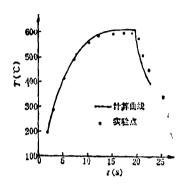
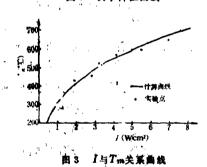


图 2 升、降温由线



四、加热实验

由图 2 和图 3 不难看出, 计算曲线与实验测得的结果符合得很好。通过改变光源电压来改变光强, 从而可使温度得到改变。电压误差造成的温度误差由下式表示

$$\Delta T_{\rm m}/T_{\rm m} = \Delta V/2V \tag{5}$$

当温度约为600°C时,基本上是电压改变1V而温度可改变1°C。假如在实验中每次把电压加到同一数值,检验出的温度重复性是很好的。如把电压加到200V,15s后晶片总是被加热到595°C左右,而各次温差均在5°C之内。

一般化学处理后的 GaAs 表面的主要污 染物是碳和 GaAs 的氧化物。用 X 射线光电 子能谱[7] 观察上述加热的表面, 其清洁过 程为: 当加热到350°C时,碳污染大量减少, 在温度达380°C后, 其减少率减缓,而氧化物 没有变化;温度继续升高,As氧化物减少, 而Ga氧化物增加;到500°C时,As氧化物消 失, 而Ga 氧化物还在增加; 温度再继续升 高, Ga氧化物开始减少; 直到580°C左右, 所有氧化物均全部消失。为了尽量清洁表 面,随着加热温度继续增加,表面上的Ga、 As等量地蒸发,直到一等比例蒸发温度T。为 止。当温度超过 T_c 时,就出现非等量蒸发, As蒸发量超过Ga而破坏表面的1:1结构。 对GaAs(100)面T。为663°C(8), 这是大量出 现非等比例蒸发的温度。实际上 在温 度 为 610°C时开始就有少量的不等量蒸发存在,所 以加热温度一般都选择在580~650°C之间。 而加热时间则要看所选的温度确定(一般为 几分钟到半小时不等),温度越高,所需时 间越短。经上述加热处理后的 GaAs 表面, 一般都可以达到很高的清洁程度、表面呈现 清晰的LEED图样, 污染物含量都在 Auger 探测极限以下。

根据以上过程,清洁时分别把样品加热到 350°C、580°C和 610°C三个温度上。在各温度上都采用图 2 中的温度饱和 区域 上的值,这样温度和加热时间都容易控制。由于真空泵抽速小,故采用多次、间歇性加温。每次温度达饱和后再保持5°。在某一温度上连续两次加温与降温时若真空度变化基本上连续两次加温与降温时若真空度变化基就完成了。一般在 350°C上需要重复十几次,在 580°C上约要重复十次,而在 610°C上只能进行三次,否则容易出现表面光泽消失、表现 结构被破坏的现象。由于没有表面分析仪器对加热后样品的清洁度进行测试,因此,只能在不破坏表面的情况下,尽量延长加热时间或提高温度来达到清洁的目的。

五、讨 论

我们采用光辐射方法对 Ga As 进行加热 清洁处理加热过程的重复性很好,温度和时 间都容易控制。不易出现表面结构被破坏的 现象,而且光斑面积大,受热均匀性也好。 由于是外部辐射,减少了对真空 系 统 的 污 染,装置比较简单。总之,这是一种比较好 的加热方法,此方法也可应用到半导体的退 火等工艺中。

实验中如将卤钨灯改用氙灯,其效果会更好。氙灯光谱中波长大于2μm 范围的能量只占总能量的 1 %左右,其大部分能量都在波长较短的部分,这部分波段与 GaAs 的吸收谱区很匹配。但这种光源及电源成本较高。

鉴于对本工作的大力帮助作者谨对潘林 兴、雷明轩、梁爱霞、王培福、赵宝升及西 安光机所光电公司加工部、二室测试组等个 人及单位表示感谢!

参考文献

- (1) Y. Z. Liu, J. L. Moll and W. E. Spicer, Appl. Phys. Lett. 14 (1969), 9, 275
- Carlon G.Fl. Olsen, D.J. Szotak, T.J. Zamerowski and M. Ettenberg, J. Appl. Phys. 48(1977), 3, 1007
- (3) D. Andrew, J. P. Gowers, J. Phys. D 3(1970), 320
- (4) D. Rodway, Surf. Sci. 147(1984), 103
- Symp. on GaAs Inst. Phys. Soc. 208
- (6) W.G.Driscoll, W. Vanghn, Handbook of Optics, Mc. Grow Hill, New York, 1978
- (7) R. P. Vasgucz, B. F. Lewis and F. J. Grunthaner, Appl. Phys. Lett. 42(1983), 3, 293
- (8) B. Goldstein, D. J. Szostak and V.S.Ban, Surf. Sci. 57(1976), 733